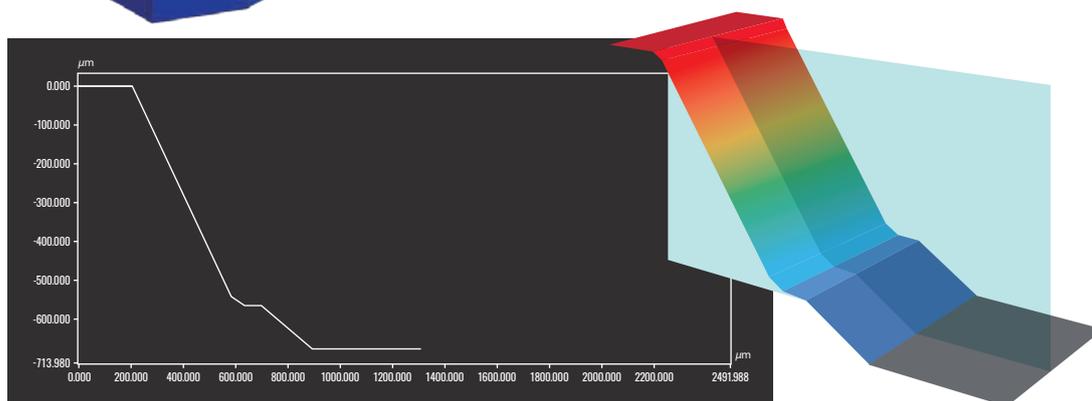
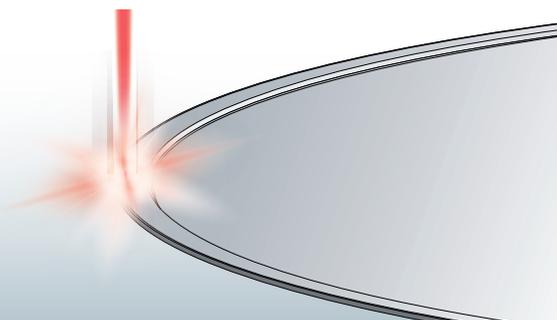
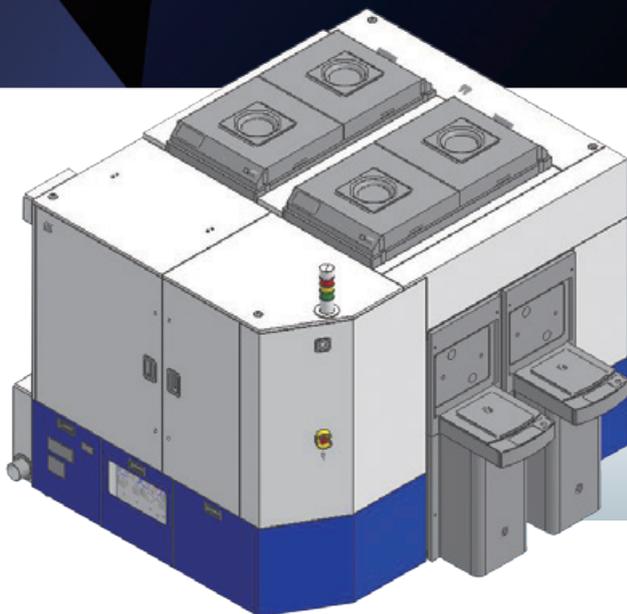


TAIKO® ウェハ加工形状測定装置

TAIKO® ウェハの加工形状を測定・計測することで、
TAIKO® 加工プロセスを最適化することが可能になります。



測定項目		再現性
	薄化部 Si 厚さ	$\sigma \leq 0.7 \mu\text{m}$
	BG テープ 厚さ	$\sigma \leq 0.5 \mu\text{m}$
	ウェハ SORI	$\sigma \leq 1.2 \mu\text{m}$
表面粗さ	Rz	$\sigma \leq 0.10 \mu\text{m}$
	Ra	$\sigma \leq 0.02 \mu\text{m}$
加工寸法	ウェハ直径	$\sigma \leq 0.04 \mu\text{m}$
	リム幅	$\sigma \leq 0.07 \mu\text{m}$
	TAIKO 加工部内径	$\sigma \leq 0.04 \mu\text{m}$
	TAIKO 加工部直径	$\sigma \leq 0.04 \mu\text{m}$
	TAIKO 加工部中心とウェハ中心のズレ	—
	酸化膜厚測定	$\sigma \leq 1.00 \text{ nm}$ (参考)
	反射率測定	$\sigma \leq 0.7\%$ (参考)

TAIKO® はディスコ株式会社の登録商標です。

神津精機株式会社 <https://www.kohzu.co.jp> お問い合わせ先 E-mail:sale@kohzu.co.jp

本社／工場 〒215-8521 神奈川県川崎市麻生区栗木2-6-15 TEL.044-981-2131 / FAX.044-981-2181

大阪支店 〒532-0004 大阪府大阪市淀川区西宮原2-7-38 新大阪西浦ビル202 TEL.06-6398-6610 / FAX.06-6398-6620